

# 2024日本电子展|日本电子加工展|日本通讯电子展

产品名称	2024日本电子展 日本电子加工展 日本通讯电子展
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	99.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

## 产品详情

2024日本电子科技博览会NEPCON JAPAN

### 【基本信息】

展会时间：2024年01月24-26日；东京Big Sight 展览馆

展会时间：2024年09月04-06日；日本千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日；名古屋展览馆

会场：东京有明展览馆

展会规模：约1200家参展商；参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

展会介绍：

亚洲领先电子研发，制造与封装技术展会，作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个专业展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”醉新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

## 展览范围：

- 1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备
- 2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务
- 3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料
- 5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

## 我司组展优势：

- 1、良好的摊位位置和价格优势。
- 2、境外行程和酒店食宿等安排一向优惠合理便捷，得到广大参展商和商务考察企业单位的\*\*\*\*！
- 3、常年操作外展经验和熟悉当地国家情况的带团人员。
- 4、从摊位确认到展台搭建及展览品运输和商务签证培训与补贴办理，公司一条龙的砖业服务理念，打造展览服务行业第一品牌！